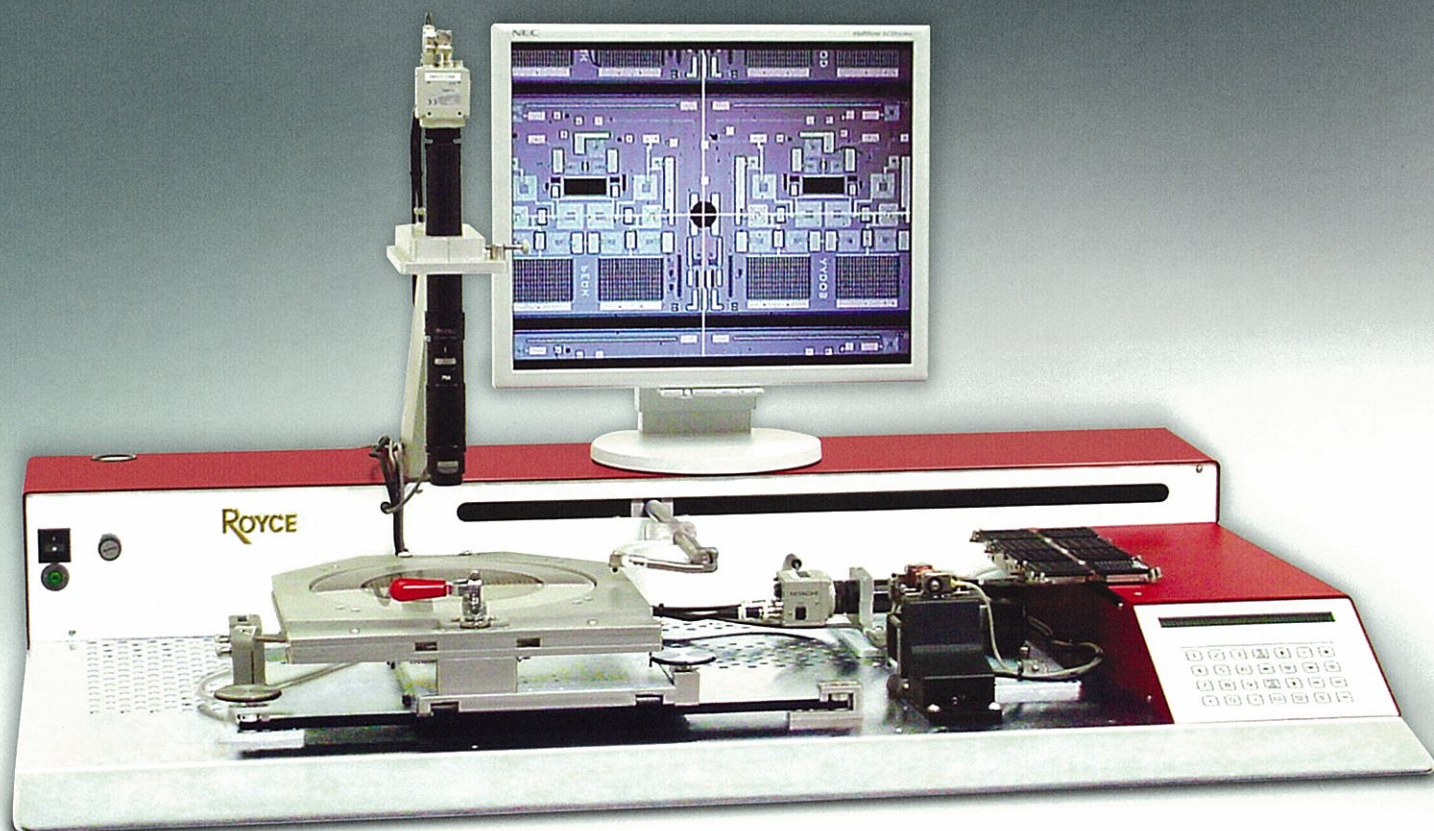




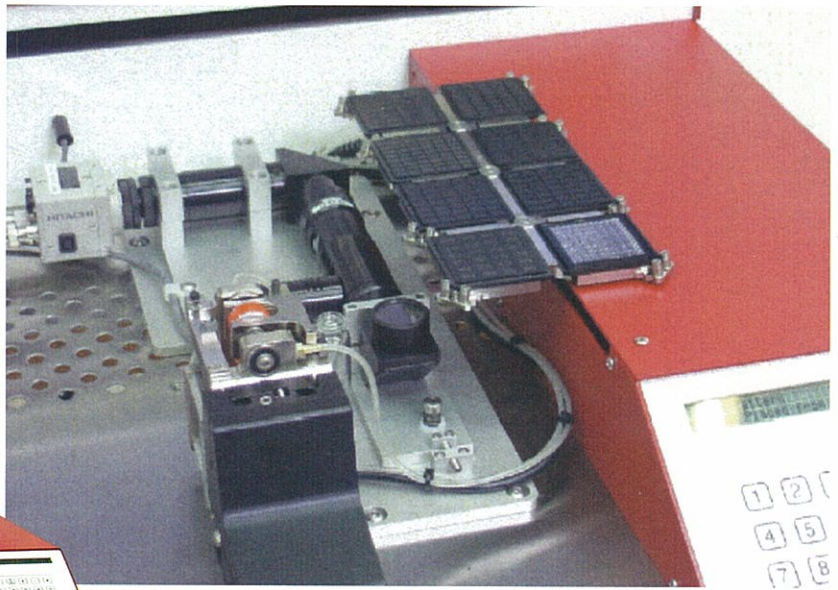
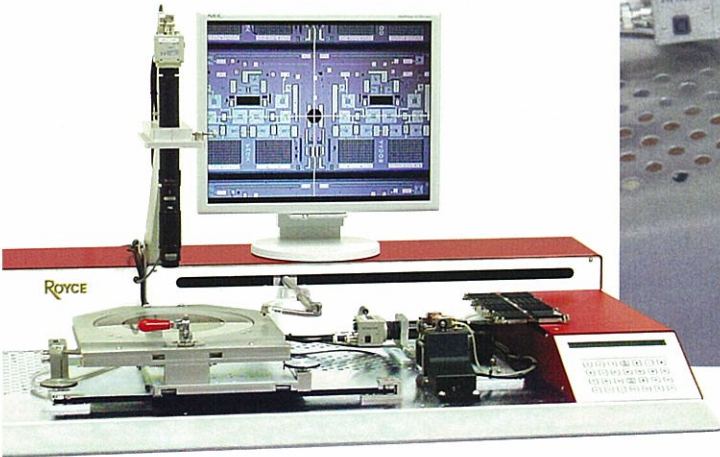
HUGLE[®]
Clean & Quality

セミオートマチックダイソータ システムDE35-ST



シンプルな設計ながら、豊富なオプションを取り揃えた安価で使い易い装置です。
特に少量多品種生産に向き、装置セットアップ及び調整も非常に容易で
オペレーターの手を煩わせることはありません。

 ヒューグルエレクトロニクス株式会社
<http://www.hugle.co.jp>



OPTION【オプション】

■ノンコンタクト (チップ表面非接触式ピックアップ)

NSC (ノン・サーフェース・コンタクト) は、チップ表面への接触が不可能なデバイス (GaAs、MEMS、センサーデバイス等) には最適です。チップサイズは、1.5mm~25mmまで対応。

■チップ裏面検査

トレー詰め前、チップ裏面の汚れ、欠け、傷、糊残りの検査が可能です。

■側面検査

チップ側面の欠け、割れ、汚れの検査、仕様により数種類の照明及び倍率が選択可能。

■高精度ダイエジェクト

デリケートなデバイスのピックアップに合わせた、高精度なエジェクターヘッドを取り揃えております。ニードルの突き上げスピード、ストローク等、精度の高い調整が可能です。

■ダイ・インバーター

ウェハーチップの表裏反転機構が可能です。

■仕様

ウェハーサイズ	200mmまで対応
チップサイズ	0.15mm [□] ~25.4mm [□]
使用トレー	2インチトレー及び4インチトレー
スループット	700~1300個/時間 (チップサイズによる)
真空	84.7kPa以上
装置サイズ	1120 (W) × 830 (D) × 762 (H) mm
装置重量	70kg

■技術仕様

精度	±127ミクロン
ダイピックアップ加重	10g以下 (調整可能)
ピックアップドライブ	ステッパーモーター
ピックアップツール	ラバー、ベスパールツール、表面非接触式ツール
ダイピックアップ位置出し	CCTV/電子ライン
フィルムフレームホルダー	拡張リング、各種ダイシングフレーム対応

※セミオートマチック ダイソータ システムDE35-STの詳細、デモのご用命は下記本社・営業所へお問い合わせ下さい。

ヒューグルエレクトロニクス株式会社

本社：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-8 TEL (03) 3263-6685 FAX (03) 3263-6686
 名古屋営業所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7 TEL (052) 220-3861 FAX (052) 220-3862
 関西営業所：〒567-0888 大阪府茨木市駅前1-2-10 TEL (072) 620-8500 FAX (072) 620-8504
 九州営業所：〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2158-26 TEL (096) 232-6131 FAX (096) 232-6133
 板橋工場：〒174-0046 東京都板橋区蓮根3-14-13 TEL (03) 3558-7911 FAX (03) 3965-7540
 鳩ヶ谷工場：〒334-0013 埼玉県鳩ヶ谷市南2-20-3 TEL (048) 284-0804 FAX (048) 286-4490
 Korea Hugle Electronics Inc.: Hugle Bldg, 86-14 Garak-Dong, Songpa-ku, Seoul, Korea TEL 82-2-431-7477 FAX 82-2-449-6295

URL <http://www.hugle.co.jp> E-mail assy@hugle.co.jp